

中信证券股份有限公司
关于中微半导体（深圳）股份有限公司
2022 年年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，负责中微半导上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与中微半导签订承销及保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解中微半导业务情况，对中微半导开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年度中微半导在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022 年度中微半导在持续督导期间未发生违法或违背承诺事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布	2022 年度，保荐机构督导中微半导及其董事、监事、高级管理人员遵守法

序号	工作内容	实施情况
	的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促中微半导体依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对中微半导的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，中微半导的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促中微半导体严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对中微半导的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2022年度，中微半导体及其董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2022年度中微半导体及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2022年度，经保荐机构核查，中微半导体不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项

序号	工作内容	实施情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022 年度，中微半导体未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2022 年度，中微半导体不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

公司实现 2022 年度归属于母公司所有者的净利润 5,917.73 万元，同比下降 92.46%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,651.02 万元，较上年同期下降 87.65%，主要原因为：（1）受到宏观经济增速放缓和行业周期影响等多方面因素的影响，消费电子市场和家电市场需求不景气，消费电子市场和家电市场需求不景气，使得公司 2022 年度营业收入和毛利率均有明显下降；（2）公司布局大家电和汽车电子芯片市场，公司研发投入超 1.2 亿元，较上年度有较大幅度增长。

（二）核心竞争力风险

公司所处的集成电路行业为技术密集型企业。公司研发水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司自上市以来,在业务快速增长的基础上不断增加研发投入,新招聘大量优秀高端人才,在保障现有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发,努力缩短新产品的研发成果转化周期。

1、产品研发风险

公司作为芯片设计公司,为适应市场新需求和新变化,坚持以研发和技术创新为引领。由于芯片设计的技术要求高、工艺复杂,且流片成本较高,若公司产品研发失败,存在前期投入资金无法收回的风险。

公司正在从事的主要研发项目包括大家电主控芯片研发项目、车规级 MCU 系列芯片研发项目、基于 55/40 纳米制程的芯片研发项目、下一代电机系列芯片项目、IGBT 及功率器件研发项目和动力电池 BMS SoC 研发项目等。上述新产品研发的开发周期较长、资金投入较大,若公司在产品规划阶段未能及时跟踪市场需求走向,或未能维持研发人员的稳定性及研发体系的稳健运作,或在研项目的下游产品技术路径、应用场景等未获市场认可,将对公司未来业绩造成一定影响;此外,若公司研发投入未能及时产业化、技术人才储备无法适应行业的技术形势,导致公司市场竞争中处于落后地位,无法及时、有效地推出满足客户及市场需求的新产品,可能会对公司市场份额和核心竞争力产生一定影响。

2、研发人才流失及技术泄密风险

集成电路设计行业属于技术密集型企业,行业内企业的核心竞争力体现在技术储备及研发能力上,对技术人员的依赖程度较高。当前公司多项产品和技术处于研发阶段,在新技术开发过程中,客观上也存在因人才流失而造成技术泄密的风险;针对人才流失风险,公司建立了包括薪酬、绩效及股权激励在内的多渠道激励模式,不断吸引行业内优秀人才,建立技术领先、人员稳定的多层次人才梯队。

另外,公司核心技术涵盖产品研发的全流程,公司的 Fabless 经营模式决定了公司需向委托加工商或合作伙伴提供相关芯片的技术资料,如因个别人员的工作疏漏、主观对外泄露或供应商管控不当等原因导致公司核心技术泄密,可能对

公司产品研发进展、产品质量等核心竞争力的产生一定的不良影响，进而影响公司业务发展和经营业绩。

（三）经营风险

1、供应商集中度较高风险

公司采取 Fabless 模式，将芯片生产及主要的封测等工序交给外协厂商负责。公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。此外，由于行业特性，晶圆制造和封装测试均为资本及技术密集型产业，国内主要由大型国企或大型上市公司投资运营，供应商集中度较高，是行业普遍现象。如果公司供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛持续出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

2、原材料及封装加工价格波动风险

公司主营业务成本主要由晶圆、封装及测试成本构成，晶圆采购成本和芯片封装测试成本变动会直接影响公司的营业成本，进而影响毛利率和净利润。晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术水平及资金规模要求极高，全球范围内知名晶圆制造厂数量较少。如果未来因集成电路市场需求量旺盛，公司向其采购晶圆的价格出现大幅上涨，将对公司经营业绩产生不利影响。

（四）财务风险

1、毛利率波动风险

公司产品的终端应用领域具有市场竞争较为激烈，产品和技术更迭较快的特点。为维持较强的盈利能力，公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新。如若公司未能契合市场需求率先推出新产品，或新产品未能如预期实现大量出货，将导致公司综合毛利率出现下降的风险。

2、存货跌价风险

公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购和生产计划。随着公司业务规模的不断扩大，存货规模随业务规模扩大而逐年上升。

若市场需求环境发生变化、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，从而存货跌价风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。

3、应收账款的坏账风险

报告期下游市场需求下滑，公司相应改变销售策略、放宽了账期，导致应收账款增加明显，同时随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加。如果未来公司应收账款管理不当或者由于某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将增加公司的经营风险。

4、汇率波动风险

公司的晶圆采购主要以美元报价和结算。随着公司总体业务规模扩大，境外销售及采购金额预计将进一步增加，虽然公司在业务开展时已考虑了合同或订单订立及款项收付之间汇率可能产生的波动，但随着国内外政治、经济环境的变化，汇率变动仍存在较大的不确定性，未来若人民币与美元汇率发生大幅波动，将对公司业绩造成一定影响。

5、税收优惠政策变动风险

根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，后续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。由于研发投入加大，四川中微芯成预计能够达到国家鼓励的重点集成电路设计企业指标，获利年度未超过 5 年，按免征企业所得税计提。

若未来上述税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件，公司将需要补缴 2022 年度企业所得税，将对公司的经营业绩产生一定影响。

（五）行业风险

公司的业务扩张主要受益于汽车电子、工业、智能家居、高端消费等应用领

域的终端产品市场的迅速增长。下游应用市场种类繁多，市场需求变化明显，但单个市场需求相对有限。如果未来下游应用发展速度放缓，整体市场增长停滞，或者公司无法快速挖掘新产品应用需求，及时推出适用产品以获取新兴市场份
额，可能会面临业绩波动的风险。

（六）宏观环境风险

1、宏观经济和行业波动风险

半导体行业是面临全球化的竞争与合作并得到国家政策大力支持的行业，受到国内外宏观经济、行业法规和贸易政策等宏观环境因素的影响。近年来，全球宏观经济表现平稳，国内经济稳中有升，国家也出台了相关的政策法规大力支持半导体行业的发展。未来，如果国内外宏观环境因素发生不利变化，可能会对公司经营带来不利影响。

2、经营受国际贸易摩擦影响的风险

近年来，国际政治、经济形势日益复杂，随着国际贸易摩擦的加剧，美国商务部已将多家中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”，并且不断扩大“实体清单”名单，加强对“实体清单”的限制。公司的客户主要以境内企业为主，上述外部因素可能导致公司为若干客户提供芯片产品和服务受到限制。公司的部分供应商无可避免地使用了美国设备或技术，可能导致其为公司供货或提供服务受到限制。一旦国际贸易摩擦的状况持续或进一步加剧，公司可能面临经营受限、订单减少或供应商无法供货等局面，若公司未能及时成功拓展新客户或供应商，极端情况下可能出现公司的营业收入下滑，令公司的经营业绩出现较大下降。因此，公司存在生产经营受国际贸易摩擦影响的风险。

四、重大违规事项

2022 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	636,793,746.12	1,109,030,496.41	-42.58
归属于上市公司股东的净利润	59,177,336.48	785,047,931.54	-92.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,510,157.30	538,417,952.74	-87.65
经营活动产生的现金流量净额	-280,037,854.20	449,287,951.10	-162.33
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,188,001,445.88	1,310,676,653.59	143.23
总资产	3,369,252,746.57	1,512,492,199.47	122.76
主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.17	2.33	-92.70
稀释每股收益 (元 / 股)	0.17	2.33	-92.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.19	1.6	-88.13
加权平均净资产收益率 (%)	3.04	85.23	减少82.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.42	58.45	减少55.03个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	19.46	9.08	增加10.38个百分点

1、2022 年度，公司实现营业收入 63,679.37 万元，较上年同期下降 42.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,917.73 万元，较上年同期下降 92.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,651.02 万元，较上年同期下降 87.65%。主要原因为受到终端需求放缓的影响，公司产品销售单价有较大幅度下降，因此销售收入、净利润均有下降。

2、2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-28,003.79 万元，较上年度下降 162.33%，主要原因为公司存货金额上涨。

3、2022 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为 318,800.14 万元，较上年度上涨 143.23%、公司总资产为 336,925.27 万元，较上年度上涨 122.76%。主要原因为公司 2022 年 8 月 5 日公开发行股票并在科创板上市，净资产和总资产金额增加。

4、基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较

上年同期下降，主要系公司净利润减少所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司在芯片设计领域深耕 20 余年，不断拓展自主设计能力，积累的自主 IP 超过 1,000 个，具有技术全面、产品线丰富、人才团队建设完善、供应链保障度高的特点。

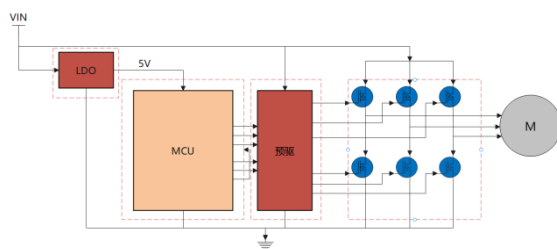
1、技术布局全、应用领域广

公司围绕智能控制器所需芯片和算法进行技术与产品布局，经过 20 余年的技术积累，具备主流系列 MCU、高精度模拟、功率驱动、功率器件、无线射频、高性能触摸和底层核心算法的设计能力，掌握各类自有 IP 超过 1,000 个；产品在 40 纳米至 180 纳米 CMOS 工艺、90 纳米至 350 纳米 BCD、高压 700V 驱动、双极、SGT MOS、IGBT 等工艺制程上投产，可供销售产品 900 余款，可满足多个细分领域不同客户对芯片功能、资源、性价比的差异化需求。全面的技术能力，使公司成为平台型的芯片设计企业，实现了芯片的结构化和模块化开发，针对不同细分领域可快速推出具有竞争优势的产品，还可为客户提供差异化、定制化服务。产品广泛应用于家电、消费类、物联网、医疗电子、工业控制、汽车电子等领域，具有应用领域广的优势。

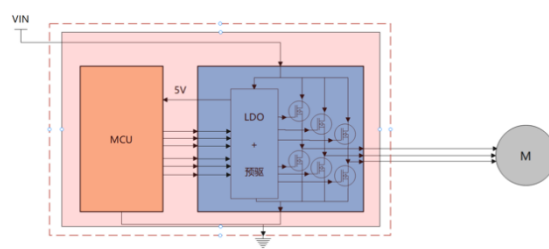
2、整合能力强、集成程度高

公司始终追求集成电路的本质，通过全面的设计技术（数字、模拟、功率器件设计能力）提升外围电子的整合能力、提高产品集成度，通过提供更多的算力、存储、集成模拟功能、管脚组合和封装形式选择，不仅可以支持嵌入式应用开发多样化的特点，而且可以为客户提供更具性价比方案，提高产品性能、降低综合成本，提升产品综合竞争力。

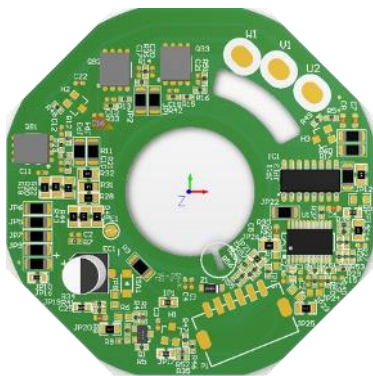
以公司电机 SoC 芯片为例，与传统方案相比，公司单芯片集成了 MCU、LDO、预驱、3 颗（P+N）MOS，一颗芯片实现了传统方案 6 颗芯片的功能，公司电机方案与传统方案的设计图与实物图对比情况如下：



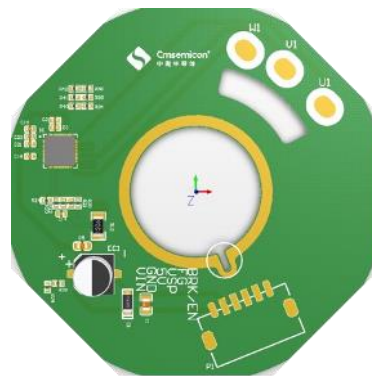
传统电机方案设计图



公司电机方案设计图



传统电机方案实物图



公司电机方案实物图

3、团队协同好、平台型开发

IC 设计行业是知识密集型行业，企业发展的关键因素是人才。公司结合不同城市的地域特点、人才储备优势和贴近市场需求进行研发团队的布局，并于 2018 年在成都购置 16 亩土地建造 22,000 平方米的研发中心，形成以成都为研发中心，以中山、重庆、北京、上海、新加坡等技术团队为支撑的“一个中心、多点支撑”的技术布局；团队分别为 IP 设计部、数字产品部、模拟产品部和功率器件部以及应用开发支持部门。

公司以 MCU 为核心的研发平台成熟，自有 IP 超过 1,000 个，面向具体应用定义产品后进行模块化、结构化设计，新产品设计，开发边际成本低，开发周期短，市场导入快，新领域营收增长快。

4、合作程度深、产能保障好

公司与主要供应商稳定合作多年。2001 年与封测厂天水华天合作，携手共同成长；2005 年与晶圆厂华虹宏力合作在国内率先推出 8 位 MCU 芯片，开启全方位、全产线深度合作，2021 年在 3 个工艺实现量产，是华虹 12 寸厂 90/55nm eFlash 工艺首发客户，同时也是少有的在其所有工艺全部量产客户；2013 年与晶圆厂 GLOBAL FOUNDRIES 合作，并开发自有 EE 存储 IP 使用至今；同时公

司寻求多晶圆厂、多工艺合作,确保晶圆产能持续增加以支撑公司快速发展;2014年与测试厂广东利扬芯片建立芯片测试合作。长期合作所积累的信誉与共同增长的产能供给与需求,加深了公司与主要供应商之间的合作,形成了合作共赢、共同发展的战略合作伙伴关系,增强供应链合作黏性,在产能上得到较为稳定的保证。此外,公司在四川遂宁建设有产能调节型的封装测试产线,增强公司封装测试的应急能力和工程批芯片即封即测的能力,提高新产品研发验证效率。

5、产品应用经验丰富、产品定义贴近市场

公司创始团队具备多年芯片应用开发经验,对终端产品应用场景具有深刻的理解。2001年公司从芯片产业链的应用开发端走向前端的研发设计,继承了芯片应用开发基因和对应用开发认识的天然优势,善于从应用端和客户功能需求角度定义芯片、规划产品,充分认识到应用开发对芯片市场推广、更新迭代的作用,保持了强大的应用开发队伍,长期对产品进行应用研究和对客户进行技术支持,促进公司产品快速推广,降低了客户开发难度,同时在对客户服务和交流中掌握终端产品的功能需求,并将获得的信息反馈给设计前端,使公司在新产品定义或升级换代中准确响应终端需求,设计出市场定位准、资源配置恰当、性能优越、性价比高、竞争力强的芯片产品。

6、产品系列全、客户群体多

公司产品系列全,包括8位和32位MCU、ASIC、混合信号SoC、功率器件等,对应的应用领域广、市场空间大。公司产能可在各产品线、领域中高效调节与配置,确保产能消耗和实现更大产能附加值;公司客户群体多,无大客户依赖,客户关系均衡,抗市场风险和持续盈利能力强。

七、研发支出变化及研发进展

2022年度公司研发投入金额12,394.12万元,较上年度增长2,329.00万元,2022年末公司研发人员数量为279人,较上年末增长15.29%;2022年度研发人员平均薪酬34.24万元,较上年度增长7.61%。

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变化幅度(%)
----	-----	-------	---------

项目	本期数	上年同期数	变化幅度(%)
费用化研发投入	123,941,202.20	100,651,226.24	23.14
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	123,941,202.20	100,651,226.24	23.14
研发投入总额占营业收入比例(%)	19.46	9.08	10.38个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	不适用

报告期内，公司推出车规级 MCU BAT32A 系列产品、面向空调室外机主控和工控领域的高性能 MCU 等新品；公司紧凑级电机应用的高性价比 CMS32M65 芯片系列实现量产，其中 CMS32M6510 作为紧凑级电机应用明星产品，大幅提高了性价比；测量类产品实现系列化。报告期内，公司推出 5 款测量类 SoC 产品，丰富了产品系列，同时具有较好性价比和市场竞争能力，可用于日常健康监测常用的额温枪、测温仪、血氧仪和相应医疗测量领域；公司功率器件已经初步系列化，SGT MOS、IGBT 和 CSP MOS 已经量产出货。

2022 年，公司新申请发明专利 11 项，获得发明专利批准 6 项；新申请实用新型专利 11 项，获得实用新型专利批准 9 项；新申请软件著作权 7 项，获得软件著作权批准 4 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

2022 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	181,650.09	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	超募资金永久补流	B2	-
	利息收入净额	B3	-
本期发生额	项目投入	C1	18,293.68
	超募资金永久补流	C2	32,000.00
	利息收入净额	C3	946.23

项目		序号	金额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,293.68
	超募资金永久补流	D2=B2+C2	32,000.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	946.23
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	132,302.64
实际结余募集资金		F	138,838.71
差异[注]		G=E-F	-6,536.07

[注] 差异 6,536.07 万元由两部分构成。1、实际结余募集资金中包含以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 6,293.68 万元和以自筹资金预先支付发行费用金额 177.45 万元，公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 6,471.13 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，6,471.13 万元还在募集资金账户中理财，尚未转出；2、实际结余募集资金中 64.94 万元，系除上述已置换资金外以公司自筹资金支付的发行费用。

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，中微半导对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中微半导实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	任职	期末持股数量 (股)	持股比例 (%)	质押、冻结及减 持情况
1	YANGYONG	董事长、核心技术 人员	126,000,000	31.47	无
2	周彦	董事、总经理	91,800,000	22.93	无
3	王继通	董事、副总经理	-	-	-
4	LIU ZEYU	董事、副总经理	-	-	-
5	罗勇	董事	16,200,000	4.05	无

序号	姓名	任职	期末持股数量 (股)	持股比例 (%)	质押、冻结及减 持情况
6	陈凯	董事	-	-	-
7	华金秋	独立董事	-	-	-
8	吴敬	独立董事	-	-	-
9	宋晓科	独立董事	-	-	-
10	蒋智勇	监事会主席	16,200,000	4.05	无
11	周飞	监事	13,500,000	3.37	无
12	冯超	职工代表监事	-	-	-
13	MIAO XIAOYU	副总经理、核心 技术人员	-	-	-
14	李振华	副总经理、核心 技术人员	450,000	0.11	无
15	吴新元	董事会秘书、财 务总监	-	-	-
16	王毅	独立董事(离 任)	-	-	-

注：YANG YONG 直接持有公司 31.47%的股份，通过顺为芯华间接持有公司股份，合计持有公司 33.03%股份；王继通通过顺为芯华、顺为致远、重庆芯继间接持有公司股份；LIU ZEYU 和 MIAO XIAOYU 通过顺为芯华间接持有公司股份；冯超通过顺为致远间接持有公司股份；李振华直接持有公司 0.11%股份，并通过顺为致远间接持有公司股份；吴新元通过顺为致远、重庆芯继间接持有公司股份。

截至 2022 年 12 月 31 日，中微半导体实际控制人和董事、监事、高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中微半导体（深圳）股份有限公司 2022 年年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

许艺彬

王 彬

中信证券股份有限公司

2023年5月16日